

インプラントアバットメントへの 補綴装置の接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



SA ルーティング®
Multi

1 補綴装置の処理

無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材の場合



必要に応じて
サンドブラスト※1

金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックスの場合



サンドブラスト※1

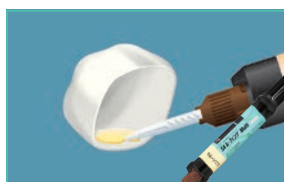
2 ペースト塗布

オートミックスの場合

又は

ハンドミックスの場合

クラウンにペースト塗布

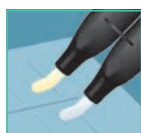


操作時間

操作時間(23℃)

1分

① AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



10秒

水分混入をさけるため練和紙、練和棒は冷蔵保管しない

② クラウンにペースト塗布

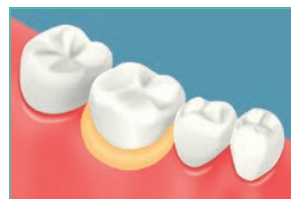


操作時間

操作時間(23℃)

2分

3 補綴装置の装着

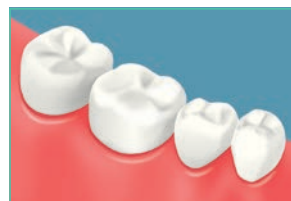


4 余剰セメントの除去※2



1か所につき2～5秒光照射

5 最終硬化(5分保持)※3



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を電子添文等にしたがって処理し(リン酸エッチング材は5秒間処理)、水洗・乾燥を行います。

※2 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。

※3 光を透過する補綴装置の場合補綴装置全体及びマージン部への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.1を参照ください。